

关于第四届集成芯片和芯粒大会 会务承办的说明

第四届集成芯片和芯粒大会（以下简称“大会”）将于2026年10月在上海隆重召开。为确保大会顺利、高效、有序举办，充分发挥专业会务机构的资源优势与执行能力，经大会相关程序筛选，现确定并授权安徽斯百德信息技术有限公司作为本次大会的会务承办方，负责大会整体统筹、全流程会务策划与执行、综合保障、各方协调对接等事宜。

授权期限：自2026年7月28日起生效，至2026年10月15日止。授权期限内，承办方需严格履行职责，不得转委托其他机构或个人承担会务工作。

陈迟晓

复旦大学

集成芯片与系统全国重点实验室

2026年7月28日
集成芯片与系统
全国重点实验室

